

اطلاعات کامل سه چیپست جدید سری اسنپدراگون، پیش از موعد رسمی فاش شد - دیجیاتو

شایان ضیایی | جمعه، ۰۸ دی ۱۳۹۶

گذشته از چیپست پرچمدار اسنپدراگون 845 که مدتی پیش معرفی شد، کمپانی کوالکام برای عرضه حداقل سه چیپست دیگر در سال 2018 برنامه ریزی کرده است: اسنپدراگون 670، اسنپدراگون 640 و اسنپدراگون 460. اگرچه این نخستین باری است که خبری درباره این سه چیپست معرفی نشده به گوش می رسد، به لطف تصویر انتشاریافته در شبکه اجتماعی Weibo، به اطلاعات کاملی از آنها دسترسی داریم.

پیش از هرچیز، به نظر می رسد کوالکام برنامه دارد از معماری مشابهی با ترکیب ARM Cortex-A55 و Cortex-A75 در چیپست های 670 و 640 استفاده کند و در همین حال، چیپست اسنپدراگون 460 به ARM Cortex-A55 محدود خواهد بود.

اسنپدراگون 670 همانطور که از نامش پیداست، قدرتمندترین چیپست در لاین آپ کوالکام پس از اسنپدراگون 845 به شمار می رود. این چیپست همراه با چهار هسته Kryo 360 Gold با فرکانس کاری 2 گیگاهرتز و چهار هسته Kryo 385 Silver با فرکانس کاری 1.6 گیگاهرتز عرضه می شود. از طرف دیگر، پردازشگر گرافیکی آدرنو 620 روی این چیپست 8 هسته ای سوار شده و می توان منتظر مودم LTE X16 کوالکام هم بود.

SoC	Snapdragon 845	Snapdragon 670	Snapdragon 640	Snapdragon 460
CPU	4x Kryo 385 Gold (A75 derivative) @ 2.80GHz 4x256KB L2 4x Kryo 385 Silver (A55 derivative) @ 1.80GHz 4x128KB L2 2MB L3	4x Kryo 360 Gold (A75 derivative) @ 2.00GHz: 4x128KB L2 4x Kryo 385 Silver (A55 derivative) @ 1.60GHz: 4x128KB L2 1MB L3	2x Kryo 360 Gold (A75 derivative) @ 2.15GHz 2x128KB L2 6x Kryo 360 Silver (A55 derivative) @ 1.55GHz 6x64KB L2 1MB L3	4x Kryo 360 Silver (A55 derivative) @ 1.80GHz 4x64KB L2 4x Kryo 360 Silver (A55 derivative) @ 1.40GHz 4x64KB L2
GPU	Adreno 630	Adreno 620	Adreno 610	Adreno 605
Memory	4x 16-bit CH @ 1066MHz LPDDR4x 29.9GB/s 3MB system cache	3x 16-bit CH @ 1066MHz LPDDR4x 22.4GB/s 2MB system cache	2x 16-bit CH @ 1066MHz LPDDR4x 14.9GB/s 1MB system cache	2x 16-bit CH @ 1066MHz LPDDR4x 14.9GB/s
ISP/Camera	Dual 14-bit Spectra 280 ISP 1x 32MP or 2x 16MP	Dual 14-bit Spectra 280 ISP 1x 26MP or 2x 13MP		14-bit Spectra 240 ISP 21MP
Integrated Modem	Snapdragon X20 LTE (Category 18/13) DL = 1200Mbps 5x20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM	Snapdragon X16 LTE (Category 16/13) DL = 1000Mbps 3x20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM	Snapdragon X12 LTE (Category 12/13) DL = 600Mbps 3x20MHz CA, 256-QAM UL = 150Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM	
Mfc.process	10nm LPP			14nm LPP

بعد از این نوبت اسنپدراگون 640 است که به دو هسته Kryo 360 Gold با فرکانس 2 گیگاهرتز و شش هسته Kryo Silver 385 با فرکانس 1.55 گیگاهرتز مجهز می شود و با پردازشگر گرافیکی Adreno 610 و مودم X12 LTE از راه می رسد. هر دو مدل 670 و 640، به کمک فرآیند 10 نانومتری FinFET سامسونگ تولید می شوند و از این لحاظ، تفاوتی با اسنپدراگون 845 ندارند.

در نهایت نیز نوبت به اسنپدراگون 640 می رسد که گرچه بازار اقتصادی را هدف قرار داده اما روی کاغذ مشخصات بسیار خوبی دارد. این چیپست هم با چهار هسته Kryo 360 Silver با فرکانس 1.8 گیگاهرتز و چهار هسته مشابه دیگر با فرکانس 1.4 گیگاهرتز روانه بازار می شود و پردازشگر گرافیکی آدرنو 605 و مودم X12 LTE را در خود جای داده است.

برخلاف سه چیپست دیگر، انتظار می رود اسنپدراگون 460 با فناوری 14 نانومتری FinFET سامسونگ تولید شود که البته به هیچ وجه خبر بدی نیست. اگرچه هنوز اطلاعاتی درباره تاریخ رونمایی سه چیپست تازه در دست نیست، اما انتظار می رود کوالکام در جریان کنگره جهانی موبایل 2018 از آنها رونمایی کند.

[دیجیاتو](#)